

IoT、自動車、ロボット、医療、ウェアラブルを具現化する技術の総合展示会

電子機器2019

トータルソリューション展

www.jpccashow.com



のせる つなぐ つくる えて ひろげる

JPCA2019 Show
第49回国際電子回路産業展
主催：一般社団法人日本電子回路工業会

JIEP 2019
マイクロエレクトロニクスショー
第33回 最先端実装技術・パッケージング展
主催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会 (JIEP)

JISSO PROTEC 2019
第21回 実装プロセステクノロジー展
主催：一般社団法人日本ロボット工業会

Total Organic Devices Expo 2019
有機デバイス総合展 2019
共催：一般社団法人日本電子回路工業会・電子デバイス産業新聞(産案タイムズ社)

WIRE Japan Show 2019
電気・光伝送技術展
共催：一般社団法人日本電子回路工業会・電線新聞((株)工業通信)

Smart Sensing 2019
主催：株式会社JTBコミュニケーションデザイン
共催：一般社団法人日本電子回路工業会

JEP/TEP Show
JEP 全国電子部品流通連合会
東京電機卸商業協同組合

結果報告書

出展者数：507社 小間数：1,372小間 / 来場者数 44,110名

2019 **6.5** WED. ▶ **6.7** FRI. 10:00-17:00
最終日は16:00まで

東京ビッグサイト 西1-4ホール&会議棟

www.jpccashow.com

本部事務局：一般社団法人日本電子回路工業会

〒167-0042 東京都杉並区西荻北 3-12-2 回路会館 2F TEL: 03-5310-2020 FAX: 03-5310-2021 E-mail: show@jpca.org

展示会運営事務局：株式会社 JTB コミュニケーションデザイン

〒105-8335 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング 13F TEL: 03-5657-0767 FAX: 03-5657-0645 E-mail: jpccashow@jtbcom.co.jp

ご挨拶

「電子機器トータルソリューション展2019(JPCA Show/マイクロエレクトロニクスショー/JISSO PROTEC/有機デバイス総合展/WIRE Japan Show/Smart Sensing/JEP/TEP Show)」は、2019年6月5日(水)～7日(金)の3日間、東京ビッグサイトにて開催され、出展者数507社、出展小間数1,372小間と盛況裡に無事終了することができました。

これもひとえに、ご後援を賜りました経済産業省をはじめ、協賛・特別協力団体各位、ご出展いただきました多くの企業の皆様のご支援とご協力の賜物と厚く御礼申し上げます。

次回開催は、2020年5月27日(水)～29日(金)「電子機器トータルソリューション展2020」を予定しておりますので、ご出展・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ここに、今回の結果を取りまとめでご報告申し上げますので、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。

実施概要



(一社)日本電子回路工業会
会長
小林 俊文



展示会運営委員会
委員長
山本 治彦



(一社)エレクトロニクス実装学会
会長
神永 晋



(一社)日本ロボット工業会
会長
橋本 康彦



(株)産業タイムズ社
代表取締役社長
泉谷 涉



(株)工業通信
代表取締役社長
井上 政基



全国電子部品流通連合会
会長
岡本 弘



株JTBコミュニケーションデザイン
代表取締役 社長執行役員
細野 顕宏

■ 会 期：2019年6月5日(水)～7日(金)

■ 開催時間：10:00～17:00(最終日は16:00まで)

■ 会 場：東京ビッグサイト 西1-4ホール&会議棟

■ 名 称：**JPCA Show 2019 第49回国際電子回路産業展**

主 催：一般社団法人日本電子回路工業会

構成展示会：2019 プリント配線板技術展

2019 半導体パッケージング・部品内蔵技術展

フレキシブルプリント配線板製品出展エリア

2019 機器・半導体受託生産システム展

JISSO PROTEC 2019 第21回実装プロセステクノロジー展

主 催：一般社団法人日本ロボット工業会

WIRE Japan Show 2019 電気・光伝送技術展

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会

電線新聞(株)工業通信

2019 マイクロエレクトロニクスショー 第33回最先端実装技術・パッケージング展

主 催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会

有機デバイス総合展 2019 IoT対応半導体・回路基板展

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会

電子デバイス産業新聞(株)産業タイムズ社

Smart Sensing 2019

主 催：株式会社JTBコミュニケーションデザイン

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会

JEP/TEP Show

主 催：全国電子部品流通連合会/東京都電機卸商業協同組合

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会

■ 後 援：経済産業省

■ 海外協力：世界電子回路業界団体協議会(WECC)加盟団体：CPCA(中国電子回路産業協会)、EIPC(欧州電子回路協会)、HKPCA(香港線路板協会)、IPC(米国電子回路協会)、IPCA(印度電子回路工業会)、ELCINA(印度電子工業会)、KPCA(韓国電子回路産業協会)、TPCA(台湾線路板協会)

■ 本部事務局：一般社団法人日本電子回路工業会

■ 協 賛：映像情報メディア学会、画像センシング技術研究会、画像電子学会、カメラ映像機器工業会、技術研究組合光電子融合基盤技術研究所、組込みシステム技術協会、コンピュータソフトウェア協会、自動車技術会、写真感光材料工業会、情報サービス産業協会、情報処理学会、情報通信ネットワーク産業協会、全国鍍金工業組合連合会、太陽光発電技術研究組合、電気学会、電気機能材料工業会、電気設備学会、電子情報技術産業協会、電子情報通信学会、銅箔工業会、日刊工業新聞社、日本アミューズメント産業協会、日本医療機器工業会、日本医療機器テクノロジー協会、日本印刷産業連合会、日本オーディオ協会、日本音響学会、日本化学工業協会、日本火災報知機工業会、日本金型工業会、日本機械工業連合会、日本金属熱処理工業会、日本計量機器工業連合会、日本検査機器工業会、日本材料科学会、日本産業機械工業会、日本自動車研究所、日本自動車部品工業会、日本真空工業会、日本精密測定機器工業会、日本電気協会、日本電気計測器工業会、日本電機工業会、日本電気制御機器工業会、日本照明工業会、日本電子デバイス産業協会、日本電子部品信頼性センター、日本電線工業会、日本配線システム工業会、日本半導体製造装置協会、日本表面処理機材工業会、日本表面真空学会、日本ファインセラミックス協会、日本分析化学会、日本分析機器工業会、日本ベアリング工業会、日本遊技関連事業協会、日本溶接協会、光産業技術振興協会、ビジネス機械・情報システム産業協会、表面技術協会、ファインセラミックスセンター

■ 展示会運営事務局：(株)JTBコミュニケーションデザイン

(順不同・敬称略)

スポンサーシップ

Platinum Sponsor



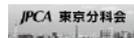
Gold Sponsor



Silver Sponsor



Bronze Sponsor



スポンサープログラムの主な内容

- アトリウムでのバナー広告設置 ●西ホールへとつながるコンコースに自社広告の看板設置
- 会場フロアマップ、公式サイトTOPページ、基調講演会場及びレセプション会場にてロゴ掲載
- 公式サイトにスポンサー特集ページ掲載 ●展示会メルマガへ社名掲載
- VIP招待券の配布(規定枚数+50部追加) ※スポンサーのグレードにより特典は異なります。

展示会結果概要

展示会・セミナーともに大盛況!



広報活動

(1) 関連業界団体との連携強化

メールマガジンの配信や機関誌への広告掲載など相互の展示会においてプロモーション活動を実施。

(2) 広告掲載媒体 (順不同)

インコム/エヌ・ティー・エス/エレクトロニクス実装技術/オートメーション新聞/化学工業日報/JARA 機関誌/新製品情報/SEMI 通信/DMカード/電子デバイス産業新聞/電線新聞/電波新聞/日刊工業新聞/日経産業新聞/日エフォーラム/プリント回路ジャーナル/メカトロニクス/Gichoビジネスコミュニケーションズ/JPCA NEWS

(3) 海外展示会出展・広告掲載実績

2018年 9月26日(水) ~ 28日(金) インド: IPCA Expo
 2018年 10月24日(水) ~ 26日(金) 台湾: TPCA Show
 2018年 12月 5日(水) ~ 7日(金) 中国: HKPCA & IPC Show
 2019年 2月27日(火) ~ 3月 1日(木) 米国: IPC APEX Expo
 2019年 3月19日(火) ~ 21日(木) 中国: 国際電子回路(上海) 展覧会(CPCA Show)
 2019年 4月24日(水) ~ 26日(金) 韓国: KPCA Show

(4) PRツール製作

国内用招待状(320,000部)、海外用招待状(データ配布)、VIP招待券(40,000部)、ポスター(1,200枚)、フロアマップ(和英)(50,000枚)、カンファレンスマップ(50,000枚)を作成。

(5) メールマガジンの配信

関連する業界団体やスポンサー企業などの協力により、会期3週間前より毎日メールマガジン配信を実施。

(6) メディア発表会の実施

昨年に引きつづき、開幕に先駆け、5月16日(木)に回路会館にてメディア発表会を実施し、14社16名のメディア関係者が参加。

開会式・ウェルカムレセプション

開会式

●日 時：6月5日(水) 9:40～10:00

●会 場：東京ビッグサイト エントランスホール

御来賓	菊川 人吾	経済産業省 商務情報政策局 情報産業	課長
開催挨拶	小林 俊文	一般社団法人日本電子回路工業会	会長
	山本 治彦	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	神永 晋	一般社団法人エレクトロニクス実装学会	会長
	橋本 康彦	一般社団法人日本ロボット工業会	会長
	泉谷 涉	株式会社産業タイムズ社	代表取締役社長
	井上 政基	株式会社工業通信	代表取締役社長
	細野 顕宏	株式会社JTBコミュニケーションデザイン	代表取締役 社長執行役員
	藤木 正則	東京都電気卸商業協同組合	理事長
	Won-Ki Nam	世界電子回路業界団体協議会 (WECC)	事務総長
	Huang Zhi Dong	中国電子回路行業協会 (CPCA)	副会長
	Alun Morgan	欧州電子回路協会 (EIPC)	会長
	Audrey Sim	香港線路板協会 (HKPCA)	理事
	Beak Taeil	韓国電子回路産業協会 (KPCA)	会長
	Maurice Lee	台湾電路板協会 (TPCA)	会長

(順不同・敬称略)

ウェルカムレセプション

出展企業及び業界関係者 800名が参加。御来賓として、磯崎 仁彦 経済産業省 経済産業副大臣にご挨拶をいただいた。

●日 時：6月5日(水) 17:30～19:30

●会 場：東京ビッグサイト レセプションホール

開催挨拶	神永 晋	一般社団法人エレクトロニクス実装学会	会長
来賓挨拶	磯崎 仁彦	経済産業省	経済産業副大臣
乾杯登壇	磯崎 仁彦	経済産業省	経済産業副大臣
	小林 俊文	一般社団法人日本電子回路工業会	会長
	山本 治彦	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	山下 博樹	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	岩城 慶太郎	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	佐藤 英志	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	神永 晋	一般社団法人エレクトロニクス実装学会	会長
	三宅 敏広	一般社団法人エレクトロニクス実装学会	JIEP 展示会運営委員会委員長
	濱 学洋	JISSO PROTEC 2019 運営委員会	委員長
	太田 裕之	JISSO PROTEC 2019 運営委員会	委員
	青田 広幸	JISSO PROTEC 2019 運営委員会	委員
	曾我 信之	JISSO PROTEC 2019 運営委員会	委員
	泉谷 涉	一般社団法人日本ロボット工業会	副会長
	井上 政基	株式会社産業タイムズ社	代表取締役社長
	渡邊 明督	株式会社工業通信	代表取締役社長
	藤木 雅則	株式会社JTBコミュニケーションデザイン	トレードショー事業部長
乾杯発声	橋本 康彦	東京都電気卸商業協同組合	理事長
中締挨拶	渡邊 明督	一般社団法人日本ロボット工業会	会長
		株式会社JTBコミュニケーションデザイン	トレードショー事業部長

(順不同・敬称略)



開会式の様子



ウェルカムレセプションの様子①



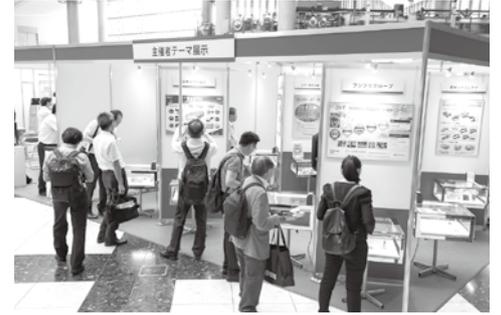
ウェルカムレセプションの様子②

主催者テーマ展示～基板の新たな可能性を探る～

主催者テーマ展示では、先進技術がより身近に感じられ、生活に変化をもたらすユニークな製品、興味が湧いてくる製品が多数展示され、来場者のみならず出展者の方々からも好評いただける展示となった。本年も、(株)産業タイムズ社の特別協力を得て、「電子デバイス産業新聞」にて特集記事を掲載。

<ul style="list-style-type: none"> ■ 5G高速通信 高周波基板用PTFE ■ プリント基板に発生するゴミ・異物問題を解決! ■ LEDCAPをご存じですか? ■ ポスト「京」スーパーコンピュータCPU MEMORY BOARD CPU MEMORY BOARD Prototype for Post-K Supercomputer ■ 3D成型回路 インモールドエレクトロニクス基板 ■ 曲げられるリジッド基板アンリジッド unrigid ■ 3D MID・3Dプリンター 配線板の提案 ■ 海塊 ■ LTCC積層セラミックスによる超小型マイクロ実験室 ■ トリリオンノード研究会のご案内 ーみんなで作るIoT/CPS ■ 3D-MID基板 ■ FPC for Automotive 自動車FPC ■ SHIRAI-JET PWB ■ 太陽インキの基板アクセサリ 	<ul style="list-style-type: none"> コミヤマエレクトロニクス エナテック 大英エレクトロニクス 富士通インターコネクトテクノロジーズ ニソール メイコー 日本シイエムケイ フェイス KOA 図研 三共化成 日本メクトロン シライ電子工業 太陽インキ製造
---	---

(順不同・法人格省略)



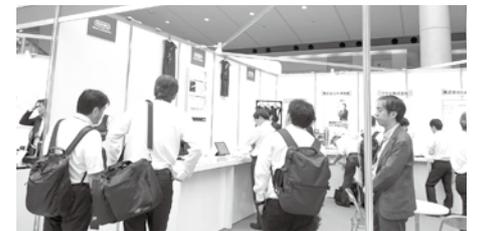
【NEW】テーマ展示 (パネル展示)

来場者と出展製品/技術等を繋ぐゲートウェイになるよう、運用・活用事例や関連技術等をアプリケーションごとに展示した。

高速伝送 (5G)	
高速通信5G対応 低誘電材料	太陽インキ製造
高速伝送用FPC	日本メクトロン
自動高周波特性測定装置 E2V6151	マイクロクラフト
高速「5G」対応 回路形成 表面処理プロセス	JCU
カプトン®高速伝送回路へのご提案	東レ・デュボン
低反発・高速伝送FPC	山下マテリアル
ヒロセ電機 5Gにおけるコネクタソリューション	ヒロセ電機
ファインパターン対応 無電解Au/Pd/Auプロセス (IGEPiG)	上村工業
5G開発プリント配線板	平山ファインテクノ
次世代高速通信 5G・ミリ波通信用銅箔	福田金属箔粉工業

車載熱対策	
高放熱・大電流基板のダイワ工業	ダイワ工業
パワーデバイス/車載機器の試験・評価	ケミトックス
材料評価用パワーデバイスの試作・評価サービス	
Blackhole for Automotive	マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン
銅インレイ配線板	日本シイエムケイ
次世代のモビリティ環境へ向けたタムラグループの車載事業展開	タムラ製作所
イオンビームによるDLCコーティング	コミヤマエレクトロニクス
e-テキスタイル	
テキスタイル技術でできたフレキシブル電線素材	
	福井県 e-テキスタイル製品開発研究会 / ふくい産業支援センター (ウラセ/KANZACC/セーレン/米澤物産)
COCOMI スマートセンシングウェア®を実現するフィルム状導電素材	東洋紡

(順不同・法人格省略)

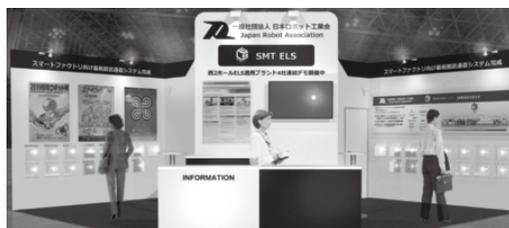


JISSO PROTEC 特別展示「ELS 対応実装機デモンストレーション」

6/5～6/7の展示会期間中に、東京ビッグサイト西展示棟のアトリウムと西1ホールの一 corner で、ELS 対応実装機の稼働デモを実施。異なるメーカーや団体関係者の垣根を超えたご協力のお陰でELSのPRが出来た。



西1ホール：実装機展示写真

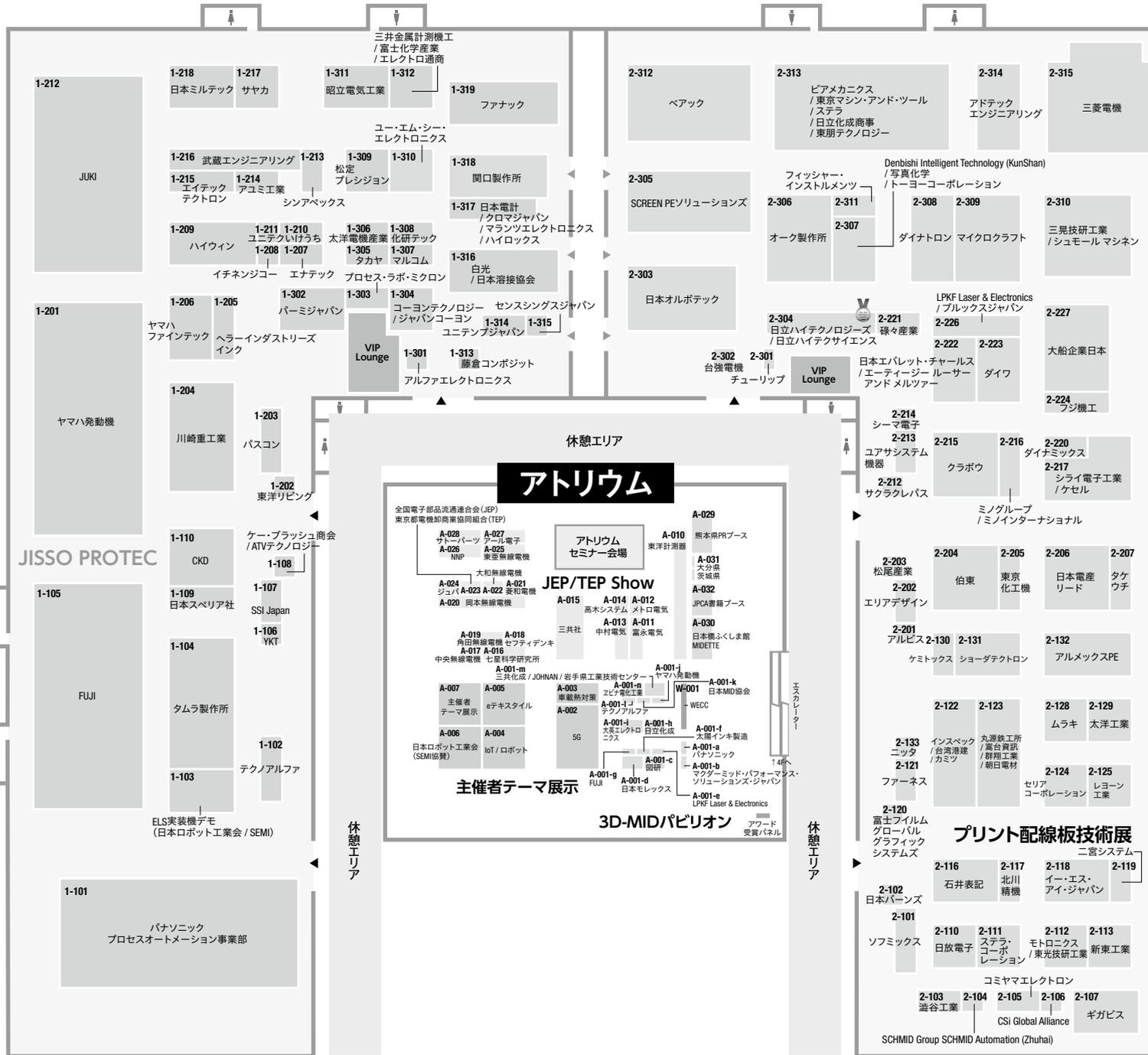


アトリウム：日本ロボット工業会 (SEMI Japan 協賛) ブースでの ELS 紹介

<ul style="list-style-type: none"> ●実装機出展企業 (50音順) JUKI (株)・パナソニック (株)・(株) FUJI・ヤマハ発動機 (株)
--

西1ホール

西2ホール



JPCA Show 2019

プリント配線板技術展

アイセロ	4-210
アイン	4-241
朝日電材	2-123
アスカエンジニアリング	3-152
アドテックエンジニアリング	2-314
アドテックジャパン	3-158
アポロ技研	4-244
アルビス	2-201
アルメックスPE	2-132
イー・エス・アイ・ジャパン	2-118
石井表記	2-116
石原ケミカル	3-225
イノテック	4-235
茨城県	A-031
イビデン	4-234
インスパック	2-122
上村工業	3-204
VENTEC INTERNATIONAL GROUP	3-165
永旺	4-231
イト工業	4-247
エーティージー ルーサー アンド メルツァー	2-222
Eternal Materials	3-224
エム・シー・ケー	2-211
エリアデザイン	2-202
LPKF Laser & Electronics	2-226
大分県	A-031
オーク製作所	2-306
大船企業日本	2-227
オカダジーエージェイ	3-216
奥野製薬工業	3-155
奥原電気	2-225
金井重要工業	2-126
カネカ	4-213
カミツ	2-122
キーサイト・テクノロジー	3-120
ギガピス	2-107
北川精機	2-117
Gichoビジネスコミュニケーションズ	3-106
協栄プリント技研	3-205
京写	4-249
キングボード	4-227
Quadcept	4-218
熊本県	A-029
クラボウ	2-215
群翔工業	2-123
グローリーフェイス	4-227
ケセル	2-217
ケミックス	2-130
互応化学工業	3-214
Goal Searchers, ZHUHAI	3-166
国際興業協会 BSEF Japan (ピーセフ ジャパン)	3-212
コムヤマエレクトロン	2-105
サイバネットシステム	4-232
相模ピーシーアイ	4-251
サクラクレパス	2-212
山栄化学	3-163
産業技術総合研究所	4-216
三晃技研工業	2-310
三晃技研工業	3-216
サンテック	2-218
Csi Global Alliance	2-106
シイエムケイ・プロダクツ	4-245
JX 金属	3-219
JXTGエネルギー	3-161
JCU	3-209
JPCA 書籍ブース	A-032
J-RAS	4-236
JADASON Enterprises	3-216
SHENGYI TECHNOLOGY	3-223
SHENZHEN JINZHOU PRECISION TECHNOLOGY	3-208
SHENZHEN NEWCESS INDUSTRIAL	3-160
シグナス	4-226
四国化成工業	3-112
四会富士電子科技	4-230
澁谷工業	2-103
写真化学	2-307
ジャブロ工業	3-226
Jiangxi Jiangnan New Material Technology	3-201
Jiangxi Uniongain Electronics Technology	4-217
Shanghai Well-Sun Precision Tool	4-250
ジュッツジャパン	2-228
SCHMID Group SCHMID Automation (Zhuhai)	2-104
シュモール マシネン	2-310
ショーダテクトロン	2-131

シライ電子工業	2-217
伸光製作所	4-241
新東工業	2-113
SCREEN PENソリューションズ	2-305
ステラ	2-313
ステラ・コーポレーション	2-111
関口製作所	1-318
セリアコーポレーション	2-124
双日プラネット	3-223
双明通信機製作所	4-244
ソフミックス	2-101
ソマール	3-218
嵩台資訊	2-123
台強電機	2-302
ダイナロン	2-308
ダイナミックス	2-220
太陽インキ製造	3-111
太洋工業	2-129
ダイワ	2-223
台湾港建	2-122
TAESUNG	3-146
タケウチ	2-207
タツタ電線	3-207
タムラ製作所	4-208
China Circuit Technology (Shantou)	4-209
チューリップ	2-301
Zhejiang Huazheng New Material	3-210
角田プラシ製作所	3-206
TR (HK) COMPANY LIMITED	4-223
DMカードジャパン	3-107
ティーシーティー・ジャパン	3-211
電波新聞社	3-104
Denbishi Intelligent Technology (KunShan)	2-307
東京化工機	2-205
東京マシン・アンド・ツール	2-313
東京マシン・アンド・ツール	3-216
東光技研工業	2-112
東朋テクノロジー	2-313
東洋バルヴ	3-215
東レ・デュボン	4-212
東和プリント工業	4-220
トーア電子	2-218
トーヨーケム	3-168
トーヨーコーポレーション	2-307
ト	3-114
ト	4-237
東莞市誠志電子	3-115
南亜新材料科技	3-167
南亜プラスチック工業	3-167
ニソール	4-238
日刊工業新聞社	3-102
ニッコー・マテリアルズ	3-224
ニッタ	2-133
日放電子	2-110
NIPPON (BOLUO) ELECTRONICS	2-115
日本通運	4-201
日本ポリテック	3-156
日本メクトロン	4-239
二宮システム	2-119
日本アグフアマテリアルズ	3-203
日本エバレット・チャールズ	2-222
日本オルボテック	2-303
日本シイエムケイ	4-245
日本テクノ	2-229
日本電産リード	2-206
日本バーンズ	2-102
日本橋ふくしま館 MIDETTE	A-030
野田スクリーン	4-243
ブリタケカンパニーリミテド	3-213
BAODING LUCKY INNOVATIVE MATERIALS	3-148
伯東	2-204
パナソニック	4-219
ハンツマンジャパン	3-121
PAN-TEC	3-216
ピアメカニクス	2-313
ピーエムティー	2-210
PCBGOGO	4-207
ピーバンドットコム	4-246
日立化成	3-217
日立化成商事	2-313
日立ハイテクサイエンス	2-304
日立ハイテクノロジー	2-304
平山ファインテクノ	4-242
ヒロセ電機	4-225
ファーマス	2-121
フィッシャー・インストルメンツ	2-311
フェイス	4-244
フジ機工	2-224
富士高分子工業	3-162

富士通インターコネクトテクノロジーズ	4-248
富士回路科技 (香港)	4-244
富士フィルムグローバルグラフィックシステムズ	2-120
富士プリント工業	4-244
プリント回路ジャーナル	3-105
ブルックスジャパン	2-226
ヘアック	2-312
マイクロクラフト	2-309
マイクロジェット	2-127
マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン	3-154
松尾産業	2-203
丸源鉄工所	2-123
三菱ガス化学	3-222
三菱電機	2-315
ミノインターナショナル	2-216
ミノグループ	2-216
ムラキ	2-128
ムラタ	3-153
メイコー	4-240
メック	3-164
メルテックス	3-157
モトロニクス	2-112
ユアシステム機器	2-213
Youchen Technology	4-202
ユニオン ツール	3-216
ライズエレクトロニクス	4-227
利昌工業	3-220
レヴィ	4-218
レヨン工業	2-125
ローム・アンド・ハース電子材料	4-212
碌々産業	2-221
ロセッタ	2-114
和仁貿易	3-216

半導体パッケージング・部品内蔵技術展

アズワン	3-119
ECI JAPAN	4-253
ウシオ電機	3-159
AJ	4-257
ケミトロン	4-254
KOA	4-252
シーマ電子	2-214
東光高岳	4-256
日本電気硝子	4-258
日本高純度化学	4-255
福岡県産業・科学技術振興財団 三次元半導体研究センター	4-206

フレキシブルプリント配線板製品出展エリア

NTW	4-204
オキツモ	4-221
沖電線	4-228
クラレ	4-211
太洋工業	4-214
ニッカン工業	4-215
八光電子工業	4-233
福田金属箔粉工業	4-229
三井金属鉱業	4-222
山下マテリアル	4-221

機器・半導体受託生産システム展

エーイーエムテック	4-224
東芝情報システム	3-116
富士電子	4-205
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1-310

3D-MIDパビリオン

岩手県工業技術センター	A-001-m
エビナ電化工業	A-001-n
LPKF Laser & Electronics	A-001-e
三共化成	A-001-m
JOHNNAN	A-001-m
函研	A-001-c
大英エレクトロニクス	A-001-i
太陽インキ製造	A-001-f
テクノアルファ	A-001-l
日本MID協会	A-001-k
日本モレックス	A-001-d
パナソニック	A-001-a
日立化成	A-001-h
FUJI	A-001-g
マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン	A-001-b
ヤマハ発動機	A-001-j

主催者テーマ展示

エナテック	A-007
KOA	A-007
コムヤマエレクトロン	A-007
三共化成	A-007

シライ電子工業	A-007
図研	A-007
SEMIジャパン	A-006
大英エレクトロニクス	A-007
太陽インキ製造	A-007
ニソール	A-007
日本メクトロン	A-007
日本シイエムケイ	A-007
日本電子回路工業会 (JPCA)	A-007
日本ロボット工業会 (JARA)	A-006
フェイス	A-007
富士通インターコネクトテクノロジーズ	A-007
メイコー	A-007

テーマ展示 (パネル展示)

ATOUN/パナソニック	A-004
上村工業	A-002
ウラセ	A-005
KANZACC	A-005
ケミトックス	A-003
コミヤマエレクトロン	A-003
JCU	A-002
セーレン	A-005
太陽インキ製造	A-002
ダイワ工業	A-003
タムラ製作所	A-003
超高効率電子回路生産システム (E-ESMAP) 研究会	A-004
デンソーウェーブ	A-004
東洋紡	A-005
東レ・デュボン	A-002
日本メクトロン	A-002
日本シイエムケイ	A-003
平山ファインテック	A-002
ヒロセ電機	A-002
福井県e-テキスタイル製品開発研究会/ふくい産業支援センター	A-005
福田金属箔粉工業	A-002
マイクログラフ	A-002
マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン	A-003
山下マテリアル	A-002
米澤物産	A-005

WECC

IPC (米国電子回路協会)	W-001
IPCA (印度電子回路工業会)	W-001
EIPC (欧州電子回路協会)	W-001
ELCINA (印度電子工業会)	W-001
HKPCA (香港線路板協会)	W-001
KPCA (韓国電子回路産業協会)	W-001
CPCA (中国電子回路産業協会)	W-001
TPCA (台湾電路板協会)	W-001

2019 マイクロエレクトロニクスショー

化学工業日報	3-108
内藤電誠工業	3-151
マコー	3-118

eX-tech

秋田化学工業	3-144
アテネ	3-130
アンドールシステムサポート	3-133
Integral Geometry Science/神戸大学 木村健次郎研究室	3-123
ウェル	3-126
AWR Japan	3-147
エスベック	3-142
エレクトロニクス実装学会 (JIEP)	3-127
大阪有機化学工業	3-122
岡本工作機械製作所	3-124
キーサイト・テクノロジー	3-135
悟空	3-171
Shimada Appli	3-150
図研	3-134
DIC	3-149
東洋紡	3-129
トープロテクノサービス	3-143
富士設備工業	3-131
富士通クオリティ・ラボ	3-170
プラズマイオンアシスト	3-145
マニファクチャリングソリューション	3-141

アカデミックプラザ

秋田大学大学院理工学研究科/SDハウエナジー	AC-10
愛媛大学 高橋研究室	AC-25
大阪産業技術研究所	AC-04
関東学院大学 理工学部/沖エンジニアリング	AC-11
関東学院大学 理工学部/フォトテクニカ	AC-12
九州大学大学院システム情報科学研究院 情報エレクトロニクス部門	AC-07
近畿職業能力開発大学校 生産電子情報システム技術科/ホータス	AC-13
群馬工業高等専門学校 機械工学科	AC-23
群馬大学大学院 知能機械創製部門	AC-09
群馬大学 理工学部 井上研究室/東レエンジニアリング電子機器サービス	AC-06
神戸大学 木村健次郎研究室/Integral Geometry Science	AC-18
山陽小野田市立山口東京理科大学 工学部 機械工学科	AC-26
信州大学 工学部	AC-16

信州大学 工学部/シチズンファインデバイス	AC-15
諏訪東京理科大学 工学部 機械電気工学科	AC-02
電子回路基板技術振興財団	AC-01
電磁材料研究所	AC-19
東京工芸大学 越地研究室	AC-14
東京都立産業技術研究センター 情報技術グループ	AC-05
同志社大学 生産システムデザイン研究室	AC-24
東北大学 学際科学フロンティア研究所 島津研究室	AC-08
長野工業高等専門学校 電子制御工学科	AC-17
日本大学 理工学部 精密機械工学科/日本大学 ニューロロボティクス研究室	AC-22
明治大学 理工学部機械工学科	AC-21
横浜国立大学大学院 工学研究科/よこはま高度実装技術コンソーシアム	AC-03
早稲田大学 情報生産システム研究センター 異研究室	AC-20

JISSO PROTEC 2019

アユミ工業	1-214
アルファエレクトロニクス	1-301
いけうち	1-210
イチネンジヨー	1-208
エイテックテクトロン	1-215
ATVテクノロジ	1-108
SSI Japan	1-107
エナテック	1-207
エレクトロ通商	1-312
化研テック	1-308
川崎重工業	1-204
クロマジャパン	1-317
ケー・ブラッシュ商会	1-108
コーヨーテクノロジー	1-304
サヤカ	1-217
CKD	1-110
ジャパコヨー	1-304
JUKI	1-212
昭立電気工業	1-311
シンアパックス	1-213
SEMIジャパン	1-103
センシングスジャパン	1-315
大洋電機産業	1-306
タカヤ	1-305
タムラ製作所	1-104
テクノアルファ	1-102
東洋リビング	1-202
日本スベリア社	1-109
日本電計	1-317
日本ミルテック	1-218
日本溶接協会	1-316
日本ロボット工業会 (JARA)	1-103
パーミジャパン	1-302
ハイウイン	1-209
ハイロックス	1-317
パスコン	1-203
白光	1-316
パナソニック プロセスオートメーション事業部	1-101
ファナック	1-319
FUJII	1-105
富士化学産業	1-312
藤倉コンポジット	1-313
プロセス・ラボ・ミクロン	1-303
ヘラーインダストリーズ インク	1-205
松定プレジジョン	1-309
マランツエレクトロニクス	1-317
マルコム	1-307
三井金属計測機工	1-312
武蔵エンジニアリング	1-216
ヤマハ発動機	1-201
ヤマハファインテック	1-206
ユニテック	1-211
ユニテックジャパン	1-314
YKT	1-106

有機デバイス総合展 2019

産業タイムズ社	3-221
ミカドテクノス	3-101

WIRE Japan Show 2019

工業通信	4-203
東洋硬化	3-202

Smart Sensing 2019

アールエスコンポーネンツ	4-128
アール・ティー・シー	4-101
アイ・アール・システム	4-158
IDTechEx	4-118
旭化成エレクトロニクス	4-111
アドコム・メディア	4-164
アドソル日進	4-103
アロマビト	4-145
イーエクスプレス	4-146
イーエルティーセンサー	4-156
イージーメジャー	4-116
イノベーションリサーチ	4-126
InPhenix	4-163
エクセルソフト	4-114

SPIエンジニアリング	4-148
エヌエステック	4-107
エネルギー ハーベスティング コンソーシアム	4-110
大阪大学 ひとつび開発グループ (東野研究室)	4-137
オートボックスセブン	4-130
オールセンサーズアジアパシフィック	4-140
ガゾウ	4-155
神奈川県立産業技術総合研究所	4-136
金沢大学 振動発電研究室	4-109
九州工業大学 井上創造研究室	4-137
九州工業大学 マイクロ化総合技術センター	4-125
京都産業大学・情報理工学部・平井研究室	4-137
クローネ	4-123
ケイエルピー	4-141
慶應義塾大学 ハプティクス研究センター	4-136
光響	4-106
光波	4-120
コーデシン	4-138
コーデシンTK	4-138
コネクテックジャパン	4-108
産総研人工知能技術コンソーシアム	4-104
CMエンジニアリング	4-134
システム計画研究所	4-152
芝浦工業大学 Emotion Sensing and Applications	4-137
シブヤ精機	4-136
情報処理学会ユビキタスコンピューティングシステム研究会	4-137
スマートジャパンアライアンス	4-103
セイコー NPC	4-129
セイコーエプソン	4-151
SEMITEC	4-159
センシリオン	4-119
Sohwa & Sophia Technologies	4-131
ソナス	4-157
ソフトエイジェンシー	4-154
第一精工	4-135
タッチエンス	4-113
東芝三菱電機産業システム	4-150
東北大学 学際科学フロンティア研究所 島津研究室	4-162
東北大学大学院工学研究科 鳥光研究室	4-127
東北大学 田中 (秀) 研究室	4-139
豊中計装	4-122
豊橋技術科学大学 ユビキタスシステム研究室	4-137
NAIST/九大ユビキタスグループ	4-137
長岡技術科学大学 カオス・フラクタル情報数理工学研究室	4-117
ナソノード	4-127
ナルテック	4-153
ネオアーク	4-143
パクリスタル/東京大学	4-160
はこだて未来大 角康之研究室	4-137
光ファイバセンシング振興協会	4-105
フジクラ	4-112
富士ゼロックス	4-121
Breezometer	4-114
ボールウェーブ	4-161
マイクロ・テクニカ	4-142
マイクロテック・ラボラトリー	4-136
マイクロマシンセンター	4-147
マイクロモジュールテクノロジー	4-133
マウザーエレクトロニクス	4-149
マクニカ	4-149
モーションリブ	4-136
MODE	4-127
山勝電子工業	4-115
ユークエスト	4-132
ユニ電子	4-127
横河電機	4-136
リンクスアーツ	4-144
ロボティクス普及促進センター	4-102

JEP/TEP Show

アール電子	A-027
NNP	A-026
岡本無線電機	A-020
角田無線電機	A-019
サトバーツ	A-028
三共社	A-015
ジュバ	A-024
セフティデンキ	A-018
全国電子部品流通連合会 (JEP)	A-023
大和無線電機	A-022
高木システム	A-014
中央無線電機	A-017
東亜無線電機	A-025
東京都電機卸商業協同組合 (TEP)	A-023
東洋計測器	A-010
富永電気	A-011
中村電気	A-013
七星科学研究所	A-016
外口電気	A-012
菱和電機	A-021



基調講演

有料

VIP無料

●日 時：6月5日(水)～7日(金) ●会場：会議棟6F 605 + 606会議室 ●聴講者数：全12セッション 1,684名(前回実績：2,610名)

5日(水)	10:45 11:30	 エッジデバイスの時代がやってきた!! ～自動車、AI、FAへの適用性が勝負～ 泉谷 渉 (株)産業タイムズ社 代表取締役社長
	11:45 12:30	 スマート製造～IoTを活用したものづくり～ 高橋 俊哉 三菱電機(株) 執行役員 FAシステム事業本部 副事業本部長
	13:30 14:15	 電子業界が直面する労働力問題と協働ロボット導入の提案 -カワサキが提案する新たなロボットシステム- 橋本 康彦 川崎重工業(株) 取締役 常務執行役員 精密機械・ロボットカンパニー プレジデント
	14:30 15:15	 次世代モビリティを支える革新的CMOS / MTJ Hybrid AIチップ開発 遠藤 哲郎 東北大学 国際集積エレクトロニクス研究開発センター センター長・教授

6日(木)	10:30 11:15	 電動車の歩みと今後の課題 安部 静生 (株)BluE Nexus 取締役
	11:30 12:15	 5Gを超えた未来への展望 尾上 誠蔵 ドコモ・テクノロジー(株) 代表取締役社長
	13:30 14:15	    『日独連合 ミラーレスカメラ』 3社によるパネルディスカッション ■パネリスト ・ライカカメラAG 主席日本代表窓口: 空中 薫 ・パナソニック(株) アプライアンス社 イメージングネットワーク事業部 商品企画部 部長: 津村 敏行 ・(株)シグマ 商品企画部 部長: 大曾根 康裕 ■司会 (株)ニコン: 後藤 哲朗
	14:30 15:15	 デジタルトランスフォーメーションを加速するAIと量子コンピューティング技術 吉山 正治 富士通(株) AIサービス事業本部 プラットフォーム事業部 事業部長

7日(金)	10:30 11:15	 Society5.0の推進 -ICTとフィジカル空間- 佐相 秀幸 内閣府 官民研究開発投資拡大プログラム (PRISM) 革新的フィジカル空間基盤技術 領域統括 兼 戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) フィジカル空間デジタルデータ処理基盤 プログラムディレクター (株)富士通研究所 シニアフェロー
	11:30 12:15	 燃料電池車とは 吉田 利彦 東京工業大学 特任教授
	13:30 14:15	 フレキシブルエレクトロニクスで創る未来社会 関谷 毅 大阪大学 栄誉教授
	14:30 15:15	 “新”高周波及びミリ波積層基材とその応用 李建興 南亜プラスチック工業(株)



JIEP 最先端実装技術シンポジウム 有料

●日 時：6月5日(水)～7日(金) ●会場：会議棟1F 101 会議室 (A会場) および102 会議室 (B会場) ●聴講者数：1,705名 (前回実績：1,593名)

		A会場		B会場	
5日(水)		5A-1 【キーノート】 5G/IoT革命で飛躍する電子業界動向 座長：松本 博文	5B-1 【キーノート】 進展著しいウェアラブル端末技術の動向 座長：小日向 茂		
	10:30 11:25	5A1-1 5Gに向けた再飛躍は可能か?ディスプレイ、部品の観点からスマートフォン業界を視る 中根 康夫 みずほ証券(株)	5B1-1 実用化が進むテキスタイル型太陽電池の動向 福田 憲二郎 (国研) 理化学研究所		
	11:25 12:15	5A1-2 世界の「5G」最新動向 岸田 重行 (株)情報通信総合研究所	5B1-2 プリントド有機エレクトロニクスが切り開く新技術分野 ー ウェアラブルからロボット応用まで ー 時任 静士 山形大学		
		5A-2 IoTへ向けた半導体、コンデンサ、AOI動向最前線 座長：土門 孝彰	5B-2 プリントブルプロセスの最新技術 座長：本多 進		
	13:35 14:30	5A2-1 どうなるスーパーサイクル 和田木 哲哉 野村證券(株)	5B2-1 エッチング工程を必要としない環境配慮型プリント配線基板製造工法の開発 加藤 義尚 福岡大学		
	14:30 15:25	5A2-2 薄膜キャパシタ (TFCP) の技術・アプリケーションのご紹介 齊田 仁 TDK(株)	5B2-2 銅ナノインクを用いた導電パターンの形成と基材との密着 南原 聡 石原ケミカル(株)		
15:25 16:20	5A2-3 進化する「ロール to ロール」 山岡 純 インスペック(株)	5B2-3 フルアディティブプロセス用Agナノインク 金原 正幸 (株)C-INK			

6日(木)		6A-1 5G対応実装技術の現状と課題 座長：猪川 幸司	6B-1 クルマの電動化を支える先進モータ技術 座長：土門 孝彰
	9:45 10:40	6A1-1 5Gから6Gモバイルへ、性能変化を支える半導体パッケージの役割と挑戦課題 西尾 俊彦 (株)SBRテクノロジー	6B1-1 モータ・インバータの動向分析と材料的課題 川崎 徹 (有)カワサキテクニクス
	10:40 11:35	6A1-2 2018-19年の最新半導体チップ群から見る最新動向 清水 洋治 (株)テカナリエ	6B1-2 SiC デバイスを用いた機電一体空冷多相重相インホイールモータ 赤津 観 芝浦工業大学
	11:35 12:30	6A1-3 FO-WLPを支えるPLP技術とWLP技術の動向 宇都宮 久修 インターコネクション・テクノロジーズ(株)	6B1-3 高効率モータを実現するアスターコイルの今後の展望と期待 本郷 武延 (株)アスター
		6A-2 日本主導で発信する5G対応FO-WLP、2.5D/3D実装技術 座長：西田 秀行	6B-2 IoT、5G時代のパワーデバイスの動向 座長：和嶋 元世
	13:35 14:30	6A2-1 先端実装技術への取り組みと“JOINT”コンソーシアム 野中 敏央 日立化成(株)	6B2-1 Si, SiC, GaNパワーデバイスの開発動向と課題 岩室 憲幸 筑波大学
14:30 15:25	6A2-2 ネガ型めっきレジストの開発状況 長谷川 公一 JSR(株)	6B2-2 高熱伝導グラファイトのパワー半導体実装への応用 山田 靖 大同大学	
15:25 16:20	6A2-3 最新パッケージのモールドング技術 三浦 宗雄 TOWA(株)	6B2-3 パワー半導体モジュールの開発 池田 良成 富士電機(株)	

7日(金)		7A-1 5G/IoTを支える材料・センサー・実装技術動向 座長：齊藤 雅之	7B-1 ウェアラブル端末用最新デバイスのセンサ最新技術 座長：本多 進
	9:45 10:40	7A1-1 トリリオンノード・エンジンが創るオープンイノベーション・プラットフォーム ー みんなで作るIoT/CPSの未来 ー 桜井 貴康 東京大学	7B1-1 最新センサの動向 ～基礎からウェアラブル用途まで～ 梶田 栄 NPO サーキットネットワーク
	10:40 11:35	7A1-2 トリリオンセンサーによる SMART Visualization ー見えないものの可視化は、判断・予測へ! 寺崎 正 (国研) 産業技術総合研究所	7B1-2 アクティブ筋音センシングスマートウェアの開発 竹井 裕介 (国研) 産業技術総合研究所
	11:35 12:30	7A1-3 5G時代に向けての基板・電子部品・実装材料の技術開発 嶋田 彰 東レ(株)	7B1-3 印刷技術で製作するフレキシブルシートセンサの活用 西 真一 (国研) 産業技術総合研究所
		7A-2 5G/V2X時代を見据えたモビリティ技術 座長：三宅 敏広	7B-2 進展著しいウェアラブル端末技術の動向 座長：小日向 茂
	13:35 14:30	7A2-1 車載プラットフォームからサポート・クラウドまでのEnd-to-End自動運転システム 馬路 徹 NVIDIA	7B2-1 多次元テキスタイル構造制御によるテキスタイルデバイスの創製 木村 睦 信州大学
14:30 15:25	7A2-3 世界の半導体産業展望とIoTの推進力 ～米中貿易摩擦の影響～ 南川 明 IHSマークイット	7B2-2 衣服型ウェアラブルデバイスの開発動向 入江 達彦 東洋紡(株)	
15:25 16:20	7A2-3 ADAS/自動運転・V2Xの可能性と市場展望 池山 智也 矢野経済研究所	7B2-3 スマートコンタクトレンズ異形実装技術 高木 裕 (株)ユニバーサルビュー	

1) 出展者 (NPI) プレゼンテーション

●日 時：6月5日(水)～7日(金) ●会場：西展示棟2階西1商談6・西展示棟2階西2商談6 ●聴講者数：1,608名(前回実績：1,549名)

●発表出展会社

(50音順)

アールエスコンポーネンツ(株)/アドソル日進(株)/アユミ工業(株)/ECI Japan(株)/イノテック(株)/上村工業(株)/LPKF Laser & Electronics(株)/オートバックセブン/
 オールセンサーズアジアパシフィック(株)/奥野製薬工業(株)/金井重要工業(株)/川崎重工業(株)/クラレ/KOA(株)/コマヤマエレクトロン(株)/サイバネットシステム(株)/JCU/ジャパンコーヨン(株)/
 シライ電子工業(株)/SCREEN PEソリューションズ(株)/ステラ・コーポレーション(株)/ソフトエイジェンシー/ダイナトロン(株)/太陽インキ製造(株)/テクノアルファ(株)/東洋バルブ(株)/ナルテック(株)/
 日本オルボテック(株)/(特非)光ファイバセンシング振興協会/日立化成(株)/日立ハイテクサイエンス/ファナック(株)/ふくおかIST三次元半導体研究センター/ブルックスジャパン/
 ㈱ プロセス・ラボ・ミクロン/松下電子材料(広州)有限公司/パナソニック(株)/三井金属鉱業(株)/メルテックス(株)/ユニオン ツール(株)

2) 第15回JPCA賞(アワード)受賞者

JPCA賞

- ハロゲンフリー超低伝送損失多層基板材料「Halogen-Free MEGTRON6」 R-5375 (E) / R-5375 (N) パナソニック(株)
- ETS用電気銅めっき浴 上村工業(株)
- 蛍光X線膜厚計の新技術を用いたプリント基板のめっき膜厚・濃度管理手法 (株)日立ハイテクサイエンス

JPCA奨励賞

- 基板熱設計のための小型・高定格部品の使いこなし KOA(株)



3) 3D-MIDパピリオンセミナー

●日 時：6月5日(水)～7日(金) ●会場：アトリウム特設セミナー会場 西展示棟2階西2商談室2 ●聴講者数：323名(前回実績：436名)

●発表出展会社

(50音順)

(地独)若手県工業技術センター/エビナ電化工業(株)/LPKF Laser & Electronics(株)/三共化成(株)/JOHNNAN(株)/図研/大英エレクトロニクス(株)/太陽インキ製造(株)/テクノアルファ(株)/日本MID協会/
 (株)FUJI

4) PROTECセミナー

●日 時：6月5日(水)～7日(金) ●会場：会議棟6F 607会議室 ●聴講者数：1,122名(前回実績：898名)

JISSO PROTEC 特別講演

実装設備の概要と今後の展開 ～2019年度版JEITA実装技術ロードマップより～
 井上 高宏
 パナソニック(株) コネクティッドソリューションズ社 JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会
 WG6(実装設備)主査

●発表出展会社

(50音順)

JUKIオートメーションシステムズ(株)/パナソニック スマートファクトリーソリューションズ(株)/
 (株)FUJI/武蔵エンジニアリング(株)/ヤマハ発動機(株)

5) アカデミックプラザ

●日 時：6月5日(水)～7日(金) ●会場：会議棟7F 701会議室および702会議室 ●聴講者数：530名(前回実績：863名)

●発表出展大学・研究機関等一覧

(50音順)

岡山大学/関東学院大学/関東学院大学大学院/近畿職業能力開発大学校/群馬大学/群馬大学大学院/群馬大学大学院理工学府/群馬工業高等専門学校/神戸大学/四国職業能力開発大学校/
 信州大学/諏訪東京理科大学/東京工芸大学/東京工芸大学大学院/東京理科大学/東京理科大学研究推進機構総合研究院/同志社大学/長野工業高等専門学校/日本大学/日本大学大学院/
 横浜国立大学大学院/龍谷大学/早稲田大学大学院

6) 2019 アカデミックプラザ受賞式

アカデミックプラザで発表される研究発表論文の中から、JIEP展示会委員会(白石委員長：群馬大学大学院 理工学府 知能機械創製部門 准教授)で優秀な論文内容が選考され、アカデミックプラザ賞受賞者が決定致しました。

■ 非懸濁浴からのZn-Al ₂ O ₃ およびZn-TiO ₂ 薄膜の作製と評価	関東学院大学大学院 工学研究科 物質生命科学専攻 小岩研究室 小岩 一郎 関東学院大学 理工学部 化学学系 小岩研究室 小岩 一郎/加美山 翔太 OKIエンジニアリング(株) 信頼性解析事業部 解析センタ 大谷 直己/立山 博丈/矢部 一博
■ 行動下発汗量計測機能を有するヘルメット型ウェアラブルデバイスの開発	諏訪東京理科大学 工学・マネジメント研究科 小須田 司 諏訪東京理科大学 電気電子工学科 中條 良亮/笹川 倭之介 日本システム開発(株) 西海 裕人 諏訪東京理科大学 コンピュータメディア工学科 清水 俊治 (株)フジタ 組田 良則 (株)高環境エンジニアリング 近藤 敏仁 諏訪東京理科大学 機械電気工学科 橋元 伸晃
■ 界面化学制御を用いたエポキシ樹脂中での銀マイクロフィラーの低温焼結誘導による導電性接着剤の高伝導化	群馬大学大学院 中澤 史穂/井上 雅博
■ 機械学習にもとづくリアルタイム打音検査の実用化	群馬大学大学院 岡 大輔/茂木 和弘/白石 洋一 (株)リアライズコンピュータエンジニアリング 小林 康博
■ ニューロ回路の搭載により生物の歩容を発現する四足歩行ロボットの開発	日本大学大学院 武井 裕樹/富増 優樹/田澤 陸/森下 克幸/金子 美泉/内木場 文男/齊藤 健
アカデミックプラザ5年連続継続賞	群馬工業高等専門学校



出展者セミナー 無料

7) JEP/TEPセミナー

- 日 時：6月5日(水)～7日(金)
- 会 場：アトリウム特設セミナー会場
- 聴講者数：107名(前回実績：54名)

●発表出展会社 (50音順)
 (株)三共社 / (株)高木システム / 東洋計測器(株) (ネットスカウトシステムズジャパン(株))



Smart Sensing 2019 Innovation Summit 無料

- 日 時：6月5日(水)～7日(金)
- 会 場：西4ホール Innovation Summit Stage
- 聴講者数：全20セッション 1,850名(前回実績：1,673名)

Keynote Speech

5日(水)	10:15-11:05	人間拡張技術でサービスビジネスを創出する 持丸 正明 (国研)産業技術総合研究所 人間拡張研究センター 研究センター長
	11:20-12:10	人の繊細さ・優しさを遠隔化・自動化するリアルハプティクス技術 永島 晃 慶應義塾大学 ハプティクス研究センター 副センター長
6日(木)	10:15-11:05	「変える」力と「つなぐ」力で、IoT実装・センサーに革命を 平田 勝則 コネクテックジャパン(株) 代表取締役 CEO
	11:20-12:10	経験者が語る、新事業開発の勘所 ～避けて通れないAI検討のポイントを添えて～ 森 重憲 (株)マクニカ 新事業本部 常務執行役員
7日(金)	10:15-11:05	AI社会実装によるサイバー・フィジカル・イノベーション ～共創アプローチ～ 本村 陽一 (国研)産業技術総合研究所人工知能研究センター / 人工知能技術コンソーシアム
	11:20-12:10	米国 CES2019と独ハノーバーメッセ2019にみる最新の潮流 青木 崇 (株)日本政策投資銀行 産業調査部 課長

企業プレゼンテーション

5日(水)	12:25-13:10	MEMSとLSIがエッジのリアルを明らかにする!エッジヘビーセンシングが拓く未来 室山 真徳 (国法)東北大学 マイクロシステム融合研究開発センター 准教授
	13:20-14:05	LPWAとセンサーでつなぐスマート社会・最新事例紹介 ～LoRaWANを活用したIoT通信プラットフォーム～ 今任 雅樹 (株)マクニカ LPWA事業推進部 部長
	14:15-15:00	超小型MEMS型 近赤外分光センサモジュールと最新のアプリケーション ケイエルブイ(株) 営業部
	15:10-15:55	革新的な転送方式が実現する次世代マルチホップ無線「UNISONet」 大原 壮太郎 ソナス(株) 代表取締役
	16:05-16:50	データ入出力デバイスとしてのロボットの活用 / 超薄型荷重センサと介護施設等での応用デバイス活用の取り組み 小林 賢一 認定NPO法人ロボティク普及促進センター 理事長 / 櫻井 仙長 (株)アール・ティ・シー 代表取締役
6日(木)	12:25-13:10	ワイヤレスセンサネットワークプラットフォーム「Tele-Sentient」のご紹介 前田 浩史郎 CMエンジニアリング(株)
	13:20-14:05	工場内の移動体の検知で簡単に解決できる5つの課題 立岡 佐到士 (株)ソフトエイジェンシー
	14:15-15:00	「匂いセンサエコシステム」の構築 緒方 健治 第一精工(株) 常務取締役 技術開発本部長 沼田 徳樹 凸版印刷(株) 情報コミュニケーション事業本部 ビジネスイノベーション推進本部 新事業開発部 課長 岡山 義光 日本電気(株) デジタルプラットフォーム事業部 技術主幹
	15:10-15:55	PoCで終わらない開発 ?なぜほとんどのプロジェクトはPoCから抜け出せないのか? 木本 彰 ロード・ジャパン・インク 営業技術メカトロシステム 部門長
	16:05-16:50	センサーデータをビジネスの価値へ - IoTのノウハウ - 上野 聡志 MODE, Inc
7日(金)	12:25-13:10	低温実装を核にしたOSRDAサービスで実現するセンシングデバイスの未来 安藤 守 コネクテックジャパン(株) 取締役 CMO
	13:20-14:05	エネルギーハーベスティングでSociety5.0を実現する - 2019年最新動向 竹内 敬治 (株)NTTデータ経営研究所 社会・環境戦略コンサルティングユニット シニアマネージャー
	14:15-15:00	ラズパイでフリーLPWAの衝撃 --- IoTイノベーションに向けたネット商社の挑戦 --- 宮原 裕人 アールエスコンポーネンツ(株) イノベーション事業部 マネージャー
	15:10-15:55	「コネクテッドな時代」だからこそ必要な Thought Leadership、およびその実現の道筋について 伊藤 佑 フロスト&サリバンジャパン(株) 成長戦略シニアマネージャー

標準化セミナー 無料

- 日 時：6月5日(水)～7日(金)
- 聴講者数：300名(前回実績：48名)

＜会議棟6F 608会議室＞ 主催者セミナー会場Ⅲ		
5日(水)	10:10-12:10	製品安全セミナー 榎場 正男 製品安全WG 主査
	＜西展示棟＞ アトリウム特設セミナー会場	
5日(水)	14:50-15:35	JPCAガイドライン フレキシブルプリント配線板の高速伝送線路試験法 高速伝送用電子回路基板WG 外山 敬三委員
	15:45-16:30	高速伝送用FPC 日本メクトロン(株)
6日(木)	10:20-11:50	「熱の伝わり方の基本」セミナー 島山 友行 富山県立大学／鈴木 康一 山口東京理科大学
	14:50-15:35	カプトンの高速伝送対応について 東レ・デュボン(株)
	15:45-16:30	低反発・高速伝送FPC 山下マテリアル(株)
7日(金)	14:10-14:55	高速伝送(5G・ミリ波)対応銅箔 福田金属箔粉工業(株)
	15:05-15:50	JPCAガイドライン フレキシブルプリント配線板の高速伝送線路試験法 高速伝送用電子回路基板WG 浦西 泰弘委員

主催者セミナー 無料

- 日 時：6月5日(水)～7日(金) ●会 場：＜会議棟6階 609会議室＞主催者セミナー会場I
- 聴講者数：ダントツものづくりセミナー942名(前回実績：1,049名)

ダントツものづくりセミナー		
5日(水)	ものづくり人財生産性向上セッション	
	13:00-13:50	【特別講演】トヨタ式現場管理 田中 正知 ものづくり大学名誉教授／元・トヨタ生産調査部 部長 J-コスト研究所 代表取締役
	13:50-14:30	【特別講演】現場改善のJコスト理論(ROA経営)による強化策 田中 正知 ものづくり大学名誉教授／元・トヨタ生産調査部 部長 J-コスト研究所 代表取締役
	14:30-15:10	リーン生産方式で、職場をもっと明るく楽しく! 成沢 俊子 ピーキューブ(株) 代表取締役社長
	15:10-15:50	トヨタ生産方式の逆襲 鈴村 尚久 エフ・ピー・エム研究所 所長／トヨタ生産方式コンサルタント
15:50-16:30	現場改善の実際 人と組織を動かす新しい生産革新の方向性 柳田 俊明 JPCAものづくり改善インストラクタ／(株)岩城生産システム研究所 コンサルタント	
6日(木)	IoT、ロボットの最新事例セミナー	
	10:00-11:00	工場におけるIoTの先進動向 前田 智彦 富士通(株) 次世代営業本部 ものづくりビジネスセンター ビジネス戦略企画部 エキスパート
	11:00-12:00	デンソーウェーブにおける協働ロボットの活用技術・事例及び今後の展開 澤田 洋祐 (株)デンソーウェーブ FA・ロボット事業部 製品企画室 室長
	ものづくりIoT／ロボット導入事例セッション	
	13:00-13:50	【特別講演】グローバル・リーン・オートメーションの現状と将来 近野 泰 (株)野村総合研究所 コンサルティング事業本部 パートナー 主席コンサルタント
	13:50-14:30	【基調講演】ダントツものづくりNo.1プロジェクト活動紹介(5か年を総括する) 山本 治彦 JPCA副会長 / 超高効率電子回路生産システム(E-ESMAP)研究会 代表幹事/JPCAものづくりアカデミー校長
	14:30-15:10	業界初! ロボット導入中小同業他社連携体の活動報告 WG主査・連携体幹事会社 E-ESMAP研究会 IoT/ロボット導入推進研究WG
15:10-15:50	パワーバリアレス社会への挑戦 ～あうんの呼吸で動くロボットを着よう～ 三輪 亮介 (株)ATOUN 事業推進部 部長補佐	
15:50-16:30	1時間で始めるスマートファクトリー 木村 哲也 旭鉄工(株)／i Smart Technologies(株) 代表取締役社長	
7日(金)	JPCAものづくり大賞受賞企業の改善事例報告会	
	10:00-12:00	第1回JPCAものづくり大賞受賞企業の事例報告 ものづくり大賞受賞企業「(株)京写」 準ものづくり大賞受賞企業「(株)愛工機器製作所・日本メクトロン(株)」 審査委員長賞受賞企業「板橋精機(株)・相模ピーシーアイ(株)」改善取組み事例発表 ※ JPCAものづくりアカデミー修了生 / E-ESMAP研究会会員限定
	ものづくりイノベーションセッション	
	13:00-13:40	ものづくり会計と現場改善会計(GKC) I 柘 紫乃 愛知工業大学 経営学部 経営学科 准教授
	13:40-14:20	ものづくり会計と現場改善会計(GKC) II 柘 紫乃 愛知工業大学 経営学部 経営学科 准教授
14:20-15:00	ゴーリキ生産革新活動報告 ～経営指標を劇的に改善した生産革新事例～ 強力 雄 (株)ゴーリキ 代表取締役社長	
15:00-15:50	【特別講演】 整流化を進める生産システム 福田 好朗 法政大学 名誉教授	
15:50-16:00	ダントツものづくりセミナー終了にあたり(ご挨拶) 山本 治彦 JPCA副会長 / 超高効率電子回路生産システム(E-ESMAP)研究会 代表幹事/JPCAものづくりアカデミー校長	



主催者セミナー 無料

●日 時：6月5日(水)～7日(金) ●聴講者数：ぷりんとばんじゅくセミナー 250名(前回実績：275名)
 JPCA光電子回路実装標準化セミナー 64名(前回実績：107名)
 「日本の電子回路産業2019」発行報告会 77名(前回実績：89名)
 2019年度版プリント配線技術ロードマップセミナー 359名

ぷりんとばんじゅくセミナー <会議棟6階 608会議室> 主催者セミナー会場II		
5日(水)	10:30-12:00	ぷりんと配線板全般について“ぷりんとばんじゅくI”をもとに基礎から解説Part1 小林 正 小林技術事務所
	13:00-14:30	ぷりんと配線板設計について“ぷりんとばんじゅくII”をもとに基礎から解説 田中 弘文 (株)オンテック
	15:00-16:30	物作りの競争力を強める品質管理 長谷川 堅一 PWBコンサルタント
7日(金)	10:30-12:00	ぷりんとばんじゅくVをもとに実装の変遷から半導体パッケージング、電子部品などの電子回路実装について解説 榎場 正男 (株)カヤバオフィス/PWBコンサルタント

JPCA光電子回路実装標準化セミナー <会議棟6階 609会議室> 主催者セミナー会場I		
5日(水)	10:00-10:05	JPCA光電子回路実装標準化セミナー 委員長 中野 義昭(代理:高原 秀行) JPCA光電子回路標準化推進委員会 委員長
	10:05-10:30	JPCA光電子回路実装標準化セミナー 光電子回路実装の国際標準化の状況 伊藤 日出男 (国研)産業技術総合研究所 東北センター 所長代理 IEC/TC91/JWG9 (w/TC86) Convenor
	10:30-11:15	高速車載光ネットワークの開発と標準化 杉原 興浩 宇都宮大学 教授 学術院(工学部・オプティクス教育研究センター) 教授
	11:15-12:00	ナノ光ファイバを含む光ファイバ加工製品のご紹介 都丸 暁 (株)deltafiber.jp 取締役

「日本の電子回路産業2019」発行報告会 <会議棟6階 610会議室> 主催者セミナー会場II		
6日(木)	14:00-15:00	電子回路産業の現状と将来展望について 若栗 範彰 (一社)日本電子回路工業会 事業部 参事

2019年度版プリント配線板技術ロードマップセミナー <西展示棟> アトリウム特設セミナー会場		
5日(水)	12:50-13:20	2019年度版プリント配線板技術ロードマップセミナー 宇都宮 久修 ロードマップ事業WG主査/インターコネクション・テクノロジーズ(株)
6日(木)	12:50-13:20	2019年度版プリント配線板技術ロードマップセミナー 吉村 英明 富士通インターコネクトテクノロジーズ(株)
7日(金)	12:50-13:20	2019年度版プリント配線板技術ロードマップセミナー 宇都宮 久修 ロードマップ事業WG主査/インターコネクション・テクノロジーズ(株)



共催セミナー 無料

●マイクロソルダリング技術セミナー

●日 時：6月6日(木) ●会 場：<会議棟6階 608会議室> 主催者セミナー会場III ●聴講者数：474名(前回実績：406名)

6日(木)	13:30-14:00	エレクトロニクス実装の技術者教育 藤本 公三 (大)大阪大学 大学院 工学研究科 マテリアル生産科学専攻 教授
	14:00-14:30	表面実装形磁器コンデンサ/はんだこてによるはんだ付け作業上の注意点及び推奨条件のご提案 中林 種広 (株)村田製作所
	14:30-15:00	ソルダインジェクション法による貫通ビアへのソルダ充填 青木 豊広 日本アイ・ビー・エム(株)
	15:00-15:30	ニッケルレス最終表面処理プロセスが与えるはんだ接合への影響 橋爪 佳 奥野製薬工業(株)
	15:30-16:00	はんだ材料の技術動向 赤池 信一 (株)タムラ製作所

●半導体・オブ・ザ・イヤー2019

●日 時：6月5日(水) ●会 場：会議棟6階 608会議室

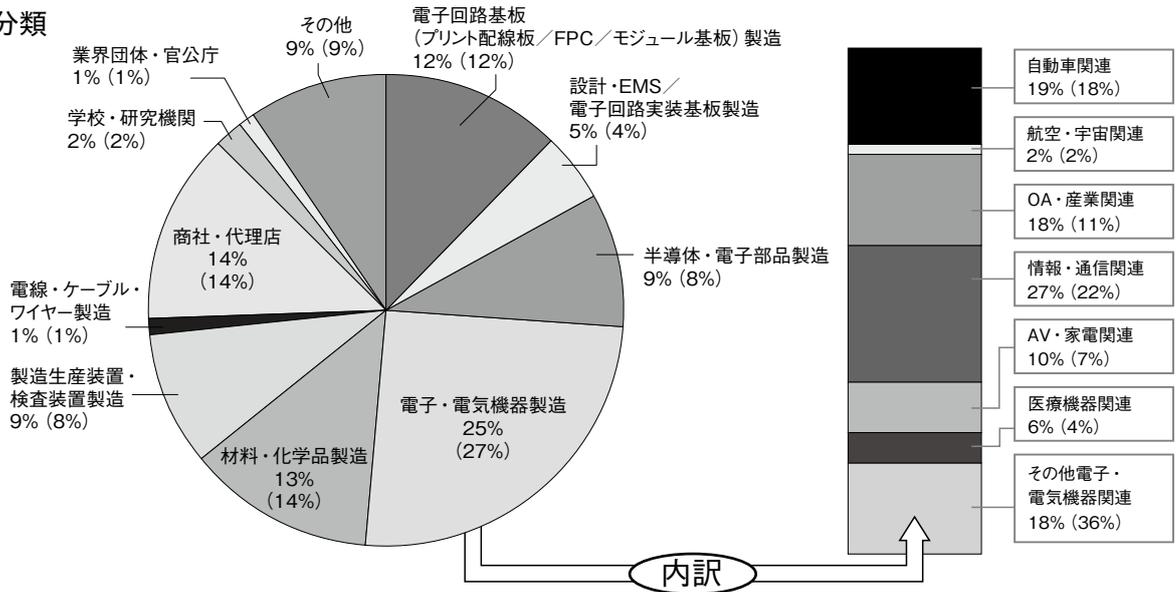
今年で第25回を迎える「半導体・オブ・ザ・イヤー2019」は、半導体デバイス部門、半導体製造装置部門、半導体用電子材料部門で選定いたしました。

5日(水)	半導体デバイス部門	グランプリ	Qualcomm Snapdragon 855 Mobile Platform
		優秀賞	(株)マイクロ・ナイトライド マイクロLEDディスプレイ用UV-LEDチップ (株)ルネサスイーストン 高感度半導体ひずみセンサー「STREAL」
半導体製造装置部門	グランプリ	レーザーテック(株) マスクプランクス欠陥検査/レビュー装置MAGICSシリーズ「M9650/M9651」	
	優秀賞	Kulicke & Soffa Industries Micro and Mini LED Solution 「PIXALUX」	
半導体用電子材料部門	グランプリ	日本ガイシ(株) 2/3/4/6インチのGaNウエハ	
	優秀賞	(株)Mナブラ スズ-銅の金属間化合物(IMCC) 鉛フリーはんだ	

全展示会実績

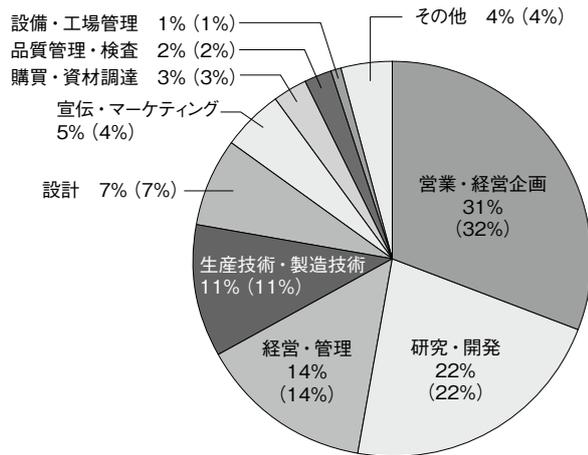
①来場者の業種分類

() 前回数値



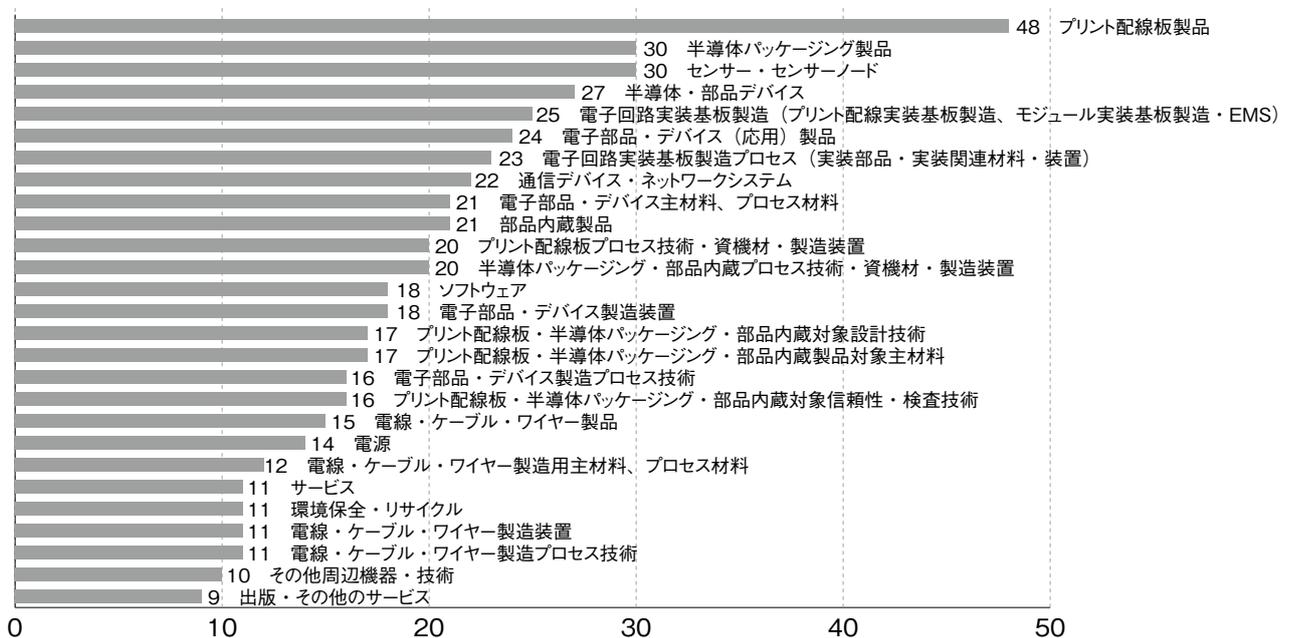
②来場者の職種分類

() 前回数値

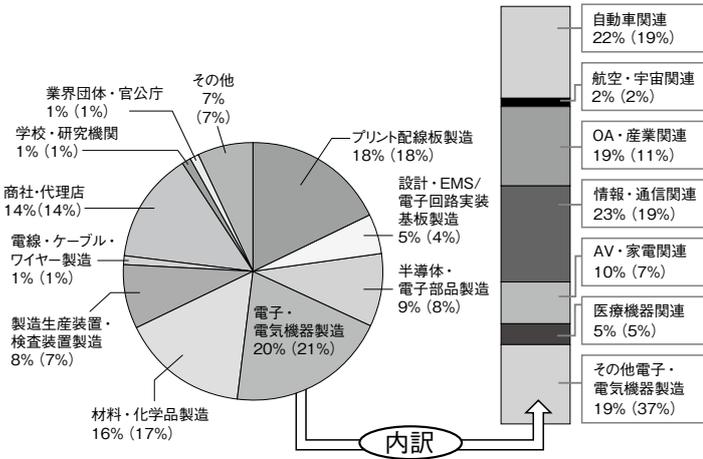


電子機器に関わる幅広い業種の方が来場している。また、経営、製造技術、研究・開発、設計など、ものづくりに関わる来場者が半数を超える。来場者の関心度が高いのはプリント配線板や半導体、センサー関連。

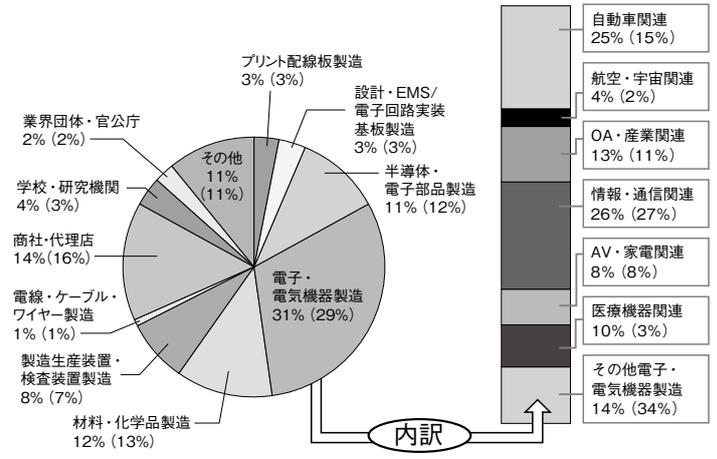
③来場者が関心のある製品分類 ※複数回答



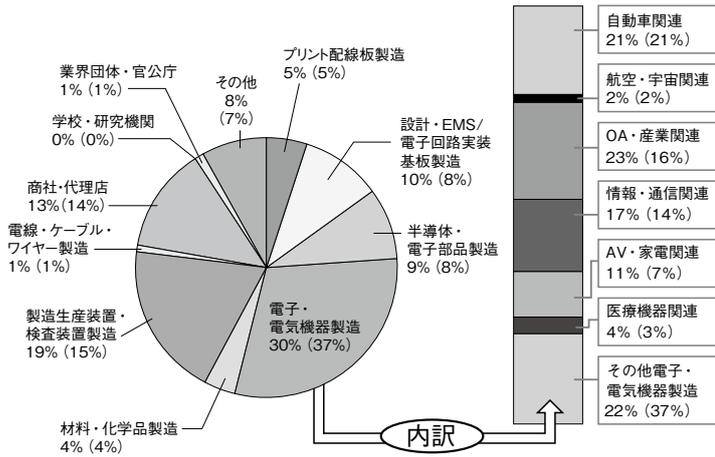
JPCA Show 2019 () 前回数値



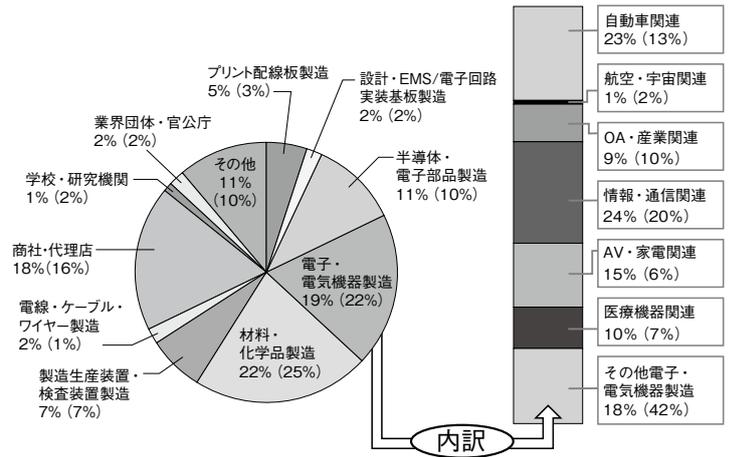
2019 マイクロエレクトロニクスショー () 前回数値



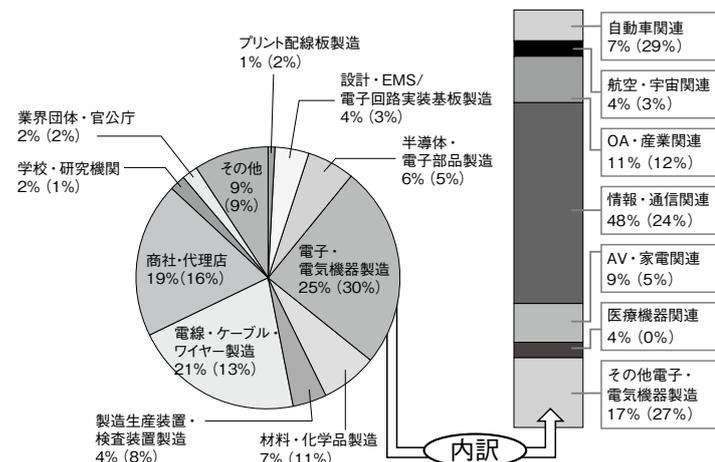
JISSO PROTEC 2019 () 前回数値



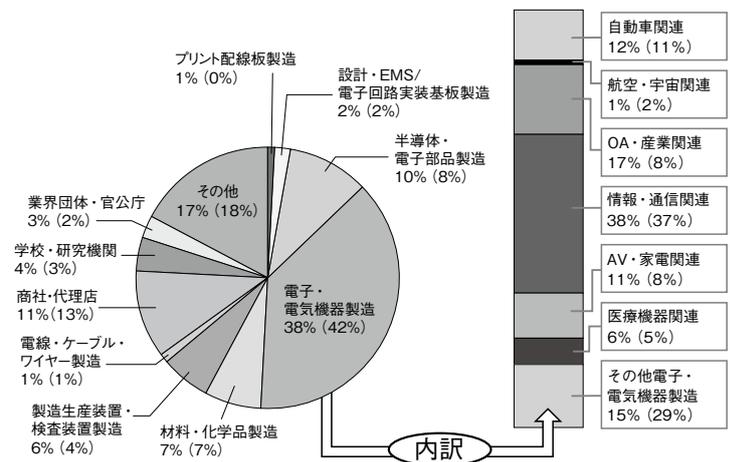
有機デバイス総合展 2019 () 前回数値



WIRE Japan Show 2019 () 前回数値

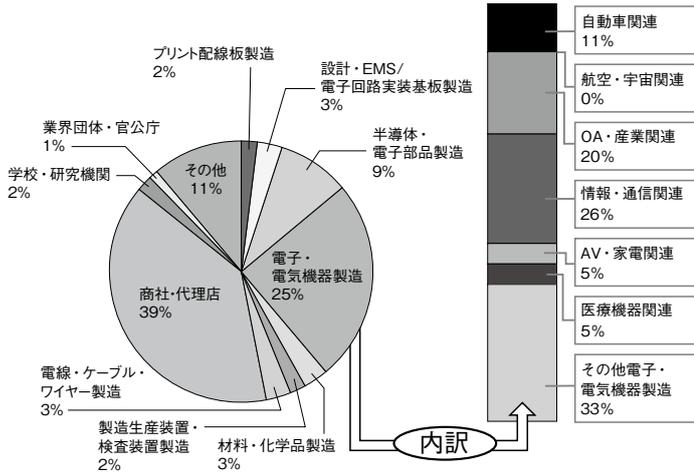


Smart Sensing 2019 () 前回数値



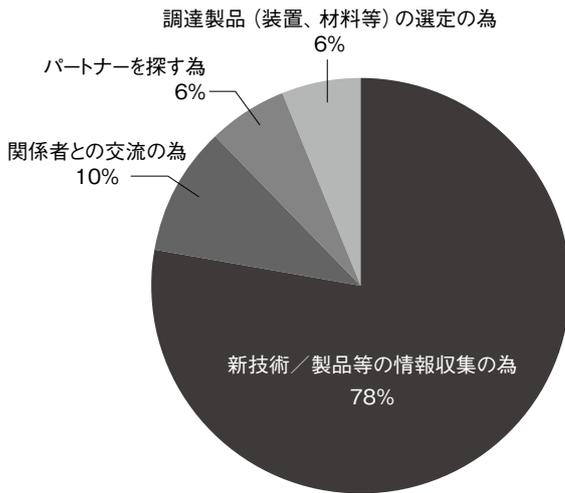
来場者分析

JEP/TEP Show

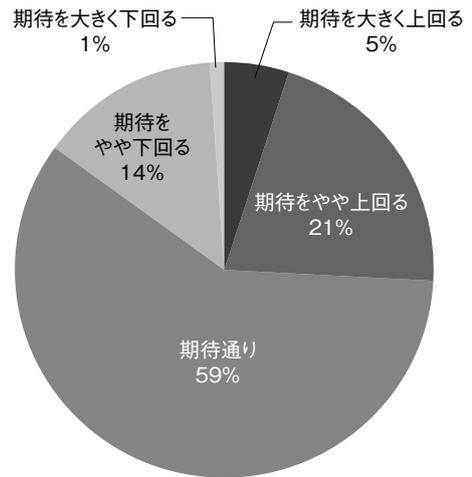


来場者アンケート

① 来場目的

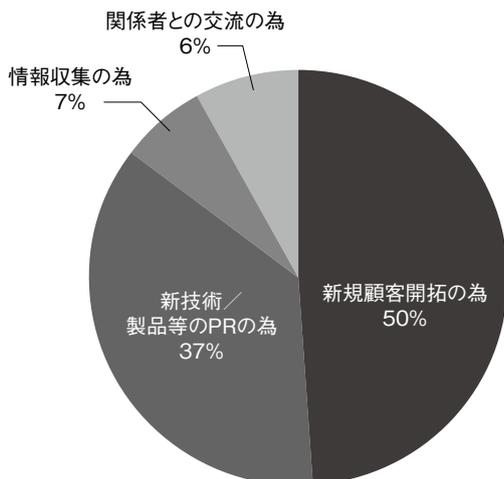


② 来場成果

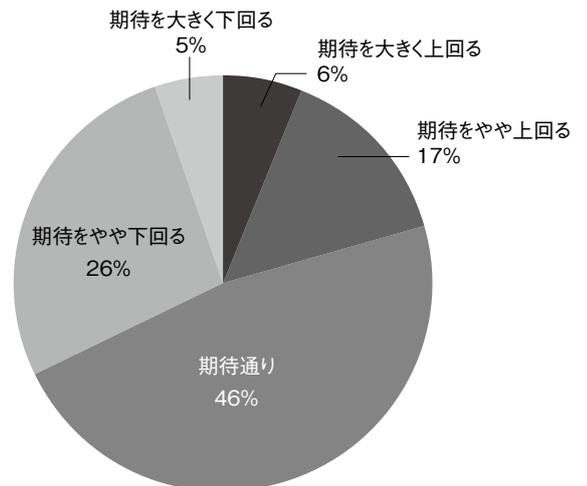


出展者アンケート

① 出展目的



② 出展成果





2019年展示会主催・運営委員会 委員

2019展示会運営委員会

- 委員長 山本 治彦
(JPCA 副会長／超高効率電子回路生産システム研究会)
- 副委員長 児嶋 一登
(JPCA 理事／(株)京写)
- 中山 明治
(JPCA 理事／日本シイエムケイ(株))
- 委員 岩城 慶太郎
(JPCA 副会長／メルテックス(株))
- 松本 博文
(JIEP 展示会事業委員会委員長／日本メクトロン(株))
- 濱 学洋
(JISSO PROTEC 2019 運営委員会委員長／JUKI(株))
- 川鍋 季明
(JEP/TEP Show 共催団体代表／(株)三共社)
- 長谷川 裕久
(Smart Sensing 共催会社代表／(株)JTBコミュニケーションデザイン)
- 泉谷 渉
(有機デバイス総合展 共催会社代表／(株)産業タイムズ社)
- 井上 政基
(WIRE Japan Show 共催会社代表／(株)工業通信)

展示会企画委員会

- 委員長 山本 治彦 (JPCA 副会長)
- 副委員長 ジュリアン・ベイショア (JPCA 理事／マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン(株))
- 委員 古屋 督生 (JPCA 理事／(株)メイコー)
- 猪川 幸司 (日本シイエムケイ(株))
- 泉谷 渉 (株)産業タイムズ社)
- 井上 政基 (株)工業通信)
- 岩城 慶太郎 (JPCA 副会長／メルテックス(株))
- 上田 裕司 (JUKIオートメーションシステムズ(株))
- 江見 佳之 (東亜電子工業(株))
- 兼子 昌和 (日本メクトロン(株))
- 後藤 哲朗 (株)ニコン)
- 長谷川 裕久 (株)JTBコミュニケーションデザイン)
- 松本 博文 (日本メクトロン(株))

JPCA 活性化委員会

- 委員長 岩城 慶太郎 (JPCA 副会長／メルテックス(株))
- 副委員長 兼子 昌和 (日本メクトロン(株))
- 委員 高見澤 栄治 (日興運送(株))

JIEP 展示会運営委員会

- 委員長 松本 博文 (日本メクトロン(株))
- 副委員長 石樽 崇明 (慶応義塾大学)
- 清水川 陽子 ((一社)日本電子回路工業会)
- 委員 土門 孝彰 (秋田銀行)
- 小日向 茂 (大阪大学)
- 猪川 幸司 (日本シイエムケイ(株))
- 高野 希 (日立化成(株))
- 加藤 義尚 (福岡大学)
- 齋藤 雅之 (株)東芝)
- 西田 秀行 (ニシダエレクトロニクス実装技術支援)
- 宝蔵寺 裕之 (産業技術総合研究所)
- 松浦 功治 (三菱電機エンジニアリング(株))
- 松岡 康信 (日本オクラロ(株))
- 本多 進 (C-NET)
- 和嶋 元世 (C-NET)
- 田畑 晴夫 (大阪大学)
- 三宅 敏広 (株)デンソー)
- 大竹 精一郎 (株)デンソー)
- 渡邊 裕彦 (富士電機(株))
- 伊藤 寿浩 (東京大学)
- 平田 勝子 (霞テクノロジー)
- 白石 洋一 (群馬大学)
- 小岩 一郎 (関東学院大学)
- 澤田 廉士 (九州大学)
- 内木場 文男 (日本大学)
- 越地 福朗 (東京工芸大学)

JISSO PROTEC 2019 運営委員会

- 委員長 濱 学洋 (JUKI(株))
- 副委員長 富士原 寛 ((一社)日本ロボット工業会)
- 委員 太田 裕之 (ヤマハ発動機(株))
- 青田 広幸 (パナソニック スマートファクトリーソリューションズ(株))
- 曾我 信之 (株)FUJI)

JISSO PROTEC 2019 実行委員会

- 委員長 上田 裕司 (JUKIオートメーションシステムズ(株))
- 副委員長 川井 建三 (ヤマハ発動機(株))
- 委員 杉友 庸一 (パナソニック(株))
- 武野 祐丸 (株)FUJI)
- 生島 直俊 (武蔵エンジニアリング(株))

JISSO PROTEC 2019 企画部会

- 部会長 上田 裕司 (JUKIオートメーションシステムズ(株))
- 副部会長 川井 建三 (ヤマハ発動機(株))
- 委員 杉友 庸一 (パナソニック(株))
- 武野 祐丸 (株)FUJI)

IoT、自動車、ロボット、医療、ウェアラブル等を具現化する技術の総合展示会

電子機器2020 トータルソリューション展

5.27 Wed. ▶ 5.29 Fri.

東京ビッグサイト 青海展示棟 全ホール

JPCA2020
Show
第50回国際電子回路産業展
主催：一般社団法人日本電子回路工業会

JIEP 2020
マイクロエレクトロニクスショー
第34回 最先端実装技術・パッケージング展
主催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会 (JIEP)

JISSO
PROTEC 2020
第22回 実装プロセステクノロジー展
主催：一般社団法人日本ロボット工業会

Total Organic Devices Expo 2020
有機デバイス総合展 2020
共催：一般社団法人日本電子回路工業会・電子デバイス産業新聞(産案タイムズ社)

W
WIRE Japan Show
2020
電気・光伝送技術展
共催：一般社団法人日本電子回路工業会・電線新聞((株)工業通信)

Smart Sensing
2020
主催：株式会社JTBコミュニケーションデザイン
共催：一般社団法人日本電子回路工業会

JEP/TEP Show

JEP 全国電子部品流通連合会
東京都電機卸商業協同組合

詳細は展示会ウェブサイトへ▶ www.jpccashow.com/

▶ お問い合わせ先 展示会運営事務局：株式会社JTBコミュニケーションデザイン
〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング13F
TEL: 03-5657-0767 FAX: 03-5657-0645 E-mail: jpcashow@jtbcom.co.jp

本部事務局：
一般社団法人日本電子回路工業会
〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2 回路会館2F
TEL: 03-5310-2020 FAX: 03-5310-2021 E-mail: show@jpca.org